

LEITERPLATTEN - ANFRAGE

Datum: _____ Visum: _____

Kunde: _____	Tel.: _____
Adresse: _____	Fax: _____
Ansprechpartner: _____	E-mail: _____

Typenbezeichnung	Index	Art der Offerte	Offert-Stückzahl	Bestellmenge	Wunschtermin
PPC-Teile Nr.: ID_ _____		<input type="checkbox"/> Prototypen <input type="checkbox"/> Serie			
Lagenzahl: _____	Lagen Multilayer				
ML-Aufbau:	<input type="checkbox"/> PPC-Standardaufbau	<input type="checkbox"/> Kunden-Aufbau (Lagenaufbau bitte beilegen)			
Material:	<input type="checkbox"/> FR4	<input type="checkbox"/> andere: _____			
Gesamtdicke über BSM:	_____ ± _____ mm				
Abmasse:	L _____ mm	B _____ mm			
Bohrdaten:	Anzahl Bohrungen pro LP: _____	davon Blind Vias: _____			
	(mechanisch gebohrt)	davon Buried Vias: _____			
	Kleinster Bohrloch-End-_: _____ mm	Grösster Bohrloch-End-_: _____ mm			
	Anzahl Mikrovias pro LP: _____	<input type="checkbox"/> Lötseite über _____ Lage/-n			
	(lasergebohrt)	<input type="checkbox"/> Bestückungsseite über _____ Lage/-n			
Leiterbild:	Leiterbahnbreite /-abstand	AL * IL * (* AL = Aussenlagen / IL = Innenlagen)			
		<input type="checkbox"/> > 200 µm			
		<input type="checkbox"/> > 150 µm; < 200 µm			
		<input type="checkbox"/> > 100 µm; < 150 µm			
		<input type="checkbox"/> > 75 µm; < 100 µm			
	Basis-Cu-Stärke	AL _____ µm	IL _____ µm		
	<input type="checkbox"/> SMD <input type="checkbox"/> BGA <input type="checkbox"/> µBGA	<input type="checkbox"/> einseitig	<input type="checkbox"/> beidseitig		
	kleinster Pitch-Abstand	LS _____ mm	BS _____ mm		
Oberflächen-ausführung	<input type="checkbox"/> Hot Air Levelling (HAL)	<input type="checkbox"/> PbSn umschmolzen			
	<input type="checkbox"/> Chem. Ni/Au	<input type="checkbox"/> Chem. Sn			
Vergoldung:	<input type="checkbox"/> Bondgold	<input type="checkbox"/> Leiterbild-/ Steckervergoldung (Hartgold)	Fläche: _____ cm ²		
Lötstopmaske:	<input type="checkbox"/> Probimer / Elpemer	<input type="checkbox"/> Siebdruck-Lack	<input type="checkbox"/> Packlayer	<input type="checkbox"/> keine	
zusätzlich:	<input type="checkbox"/> Schriftdruck	<input type="checkbox"/> auf BS <input type="checkbox"/> auf LS			
		<input type="checkbox"/> weiss (Standard)			
	<input type="checkbox"/> Abziehbarer Lötdecklack auf LS (gem. Plan/Film)				
	<input type="checkbox"/> Partieller Siebdrucklack (Schliessen der Umsteigebohrungen)				
Spezielles:	<input type="checkbox"/> Impedanzen	∩ Anzahl Impedanz Lagen: _____	; Ohmwerte: _____		
	<input type="checkbox"/> Buried- und/oder blind vias	∩ (Lagenaufbau bitte beilegen)			
	<input type="checkbox"/> Innenliegende Kapazitäten (Buried Capacitance)				
	<input type="checkbox"/> Metallcore und/oder Heatsink	∩ (gesonderte Spezifikation erforderlich)			
	<input type="checkbox"/> Nutzensauslieferung	Anzahl LP pro Nutzen: _____	<input type="checkbox"/> gefräst	<input type="checkbox"/> geritzt	
	<input type="checkbox"/> Schlechtteil auf Nutzen erlaubt				
	<input type="checkbox"/> Spezieller Nutzenrahmen	Abmessungen: _____ mm ; (Zeichnung beilegen)			
	<input type="checkbox"/> Kundenprüfstreifen				
Einpresstechnik:	<input type="checkbox"/> Bestücken der Leiterplatte	∩ (zusätzliche Spezifikationen erforderlich)			
Mitgelieferte Daten/Unterlagen:	<input type="checkbox"/> Datenfernübertragung (Mailbox/FTP-Server)	∩ (Infos siehe: www.ppc-electronic.com)			

⇒ **Feld wird von TVM / TS Mitarbeitern der PPC Electronic AG ausgefüllt !**

Fingertester: Ja Nein Datum: _____ Visum: _____

Machbarkeit bestätigt: Ja Nein

Bemerkungen:

